

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2019〕615号

计划类别：重点产业技术创新→重点研发产业化

项目编号：SGC201621

项目名称：基于物联网技术 PCB 高速数控钻孔制程
智能控制系统研发及产业化

承担单位：维嘉数控科技（苏州）有限公司

主管部门：工业园区科技和信息化局

项目合作单位：

项目负责人：邱四军、常远

项目组成员：沈海涛、刘云峰、杨超、袁绩、羊凯、
李钺果、管凌乾、陈卫

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：2019 年 03 月 01 日

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
郭旭红	苏州大学	男	机械制造	工程中心主任、教授
肖金球	苏州科技大学	男	自动化	副院长、教授
廖有用	中科院宁波材料技术与工程研究所	男	电气工程	研究员
陈艳艳	苏州纳米技术与纳米仿生研究所	女	力学专业	研究员
马云峰	致同会计师事务所	男	会计学	注册会计师/经理

项目验收意见：

受苏州市科技局委托，2019年01月18日苏州工业园区科技和信息化局组织有关专家，对维嘉数控科技（苏州）有限公司承担的“基于物联网技术PCB高速数控钻孔制程智能控制系统研发及产业化”（项目编号：SGC201621）项目进行了验收。验收委员会听取了项目汇报，审阅了有关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。

2、项目基于物联网、新型压脚切换、设计误差软件分析、CNC控制软件及运动控制、CCD精确定位和光纤通讯等技术，开发了PCB高速数控钻孔制程智能系统，实现了PCB工厂钻孔车间的智能化管理、产能及效率的提升。项目产品经苏州北测检测技术有限公司检测，产品性能指标达到合同要求。项目实施期内，申请发明专利8项，实用新型专利1项，软件著作权1项。

3、项目累计生产、销售数控PCB钻孔机92台，实现销售收入5838.58万元；利润1488.14万元；缴税总额135.19万元；新增就业51人。

4、项目总投资1648.52万元，其中市拨经费20万元，企业自筹资金1628.52万元。资金到位及时，使用合理。

验收委员会认为，项目已完成合同规定的各项指标，一致同意通过验收。